



放熱対策材料

Heat-spread Material

放熱対策現像型ソルダーレジスト PSR[®]-4000HS シリーズ

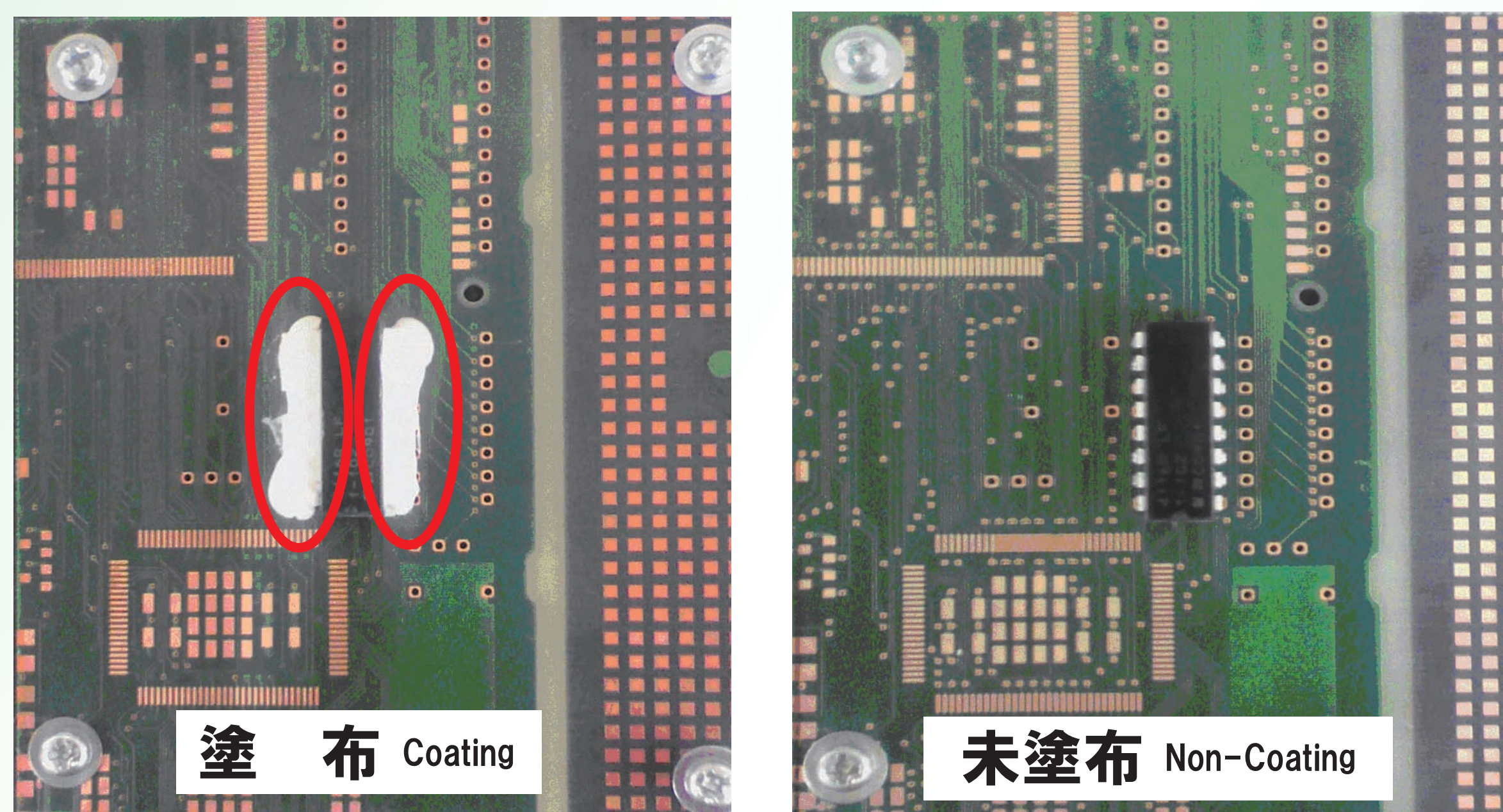
Photoimageable solder resist for Heat-spread

- **熱伝導率が一般のソルダーレジストの約 10 倍 ; 2.4W/m·K**
Thermal conductivity: app. 10 times higher (compared with general solder resist ; 2.4W/m.K)
- **プリント配線板による放熱が可能** Heat spread function by PCB itself
- **高い光反射率から LED 実装基板に対応 Y 値 : 71**
Higher reflection for LED application (Y-value 71)
- **課題であった解像性・ハレーション・現像性を改良**
Modified ink improved conventional problems, upgraded resolution and halation

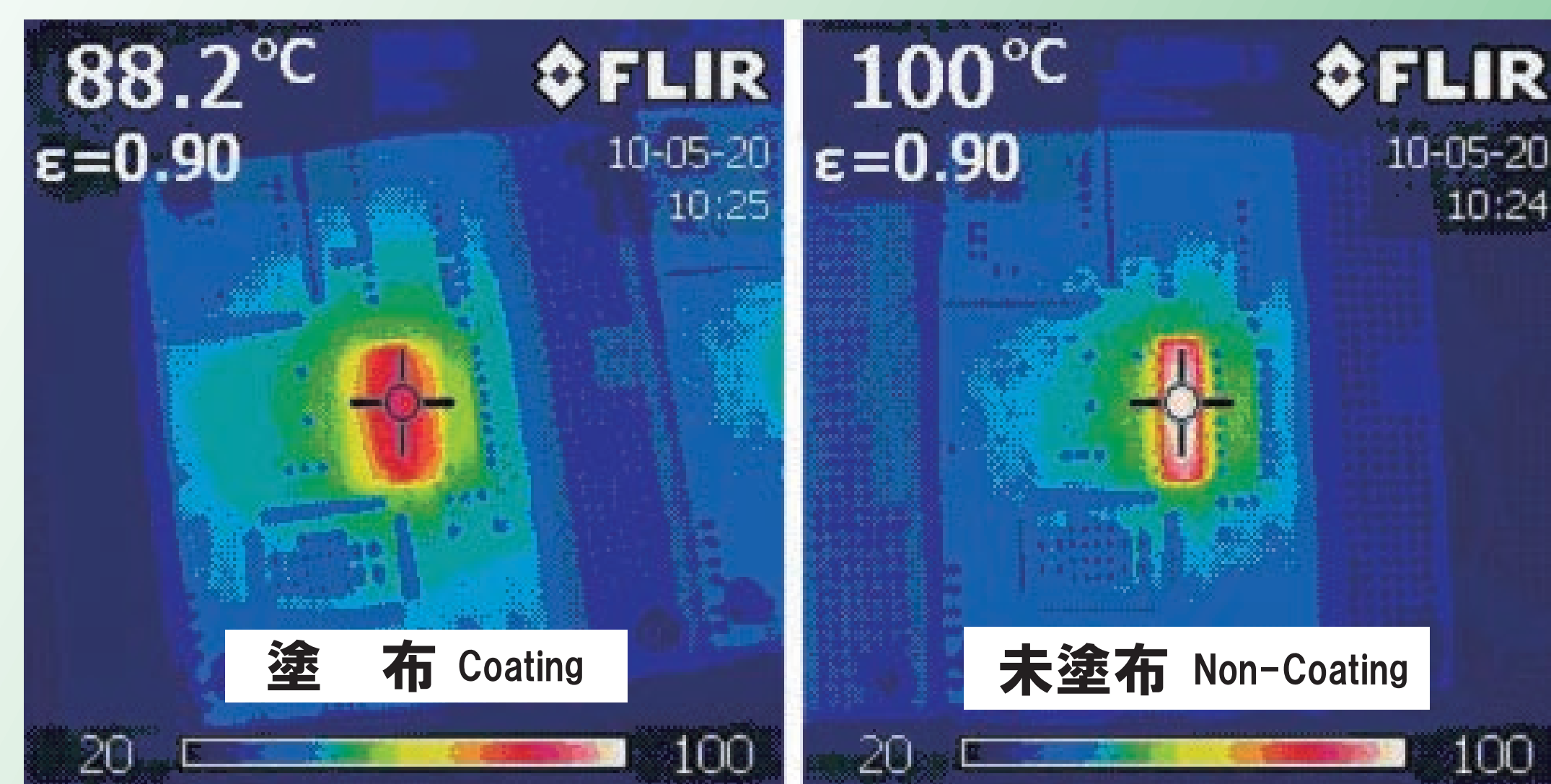
UV硬化型放熱ペースト

UV-curable Heat-spread Paste

- **放熱性に優れ冷却効果がある** Excellent heat-spreading with cool-off effect
- **有機溶剤を含有しない** Solvent-free
- **紫外線による速硬化タイプ** UV type — quick curing process
- **1.4mm 超の厚膜硬化が可能** Applicable to high thickness application over 1.4mm
- **絶縁性を有する** Insulation material
- **シロキサンフリー** Siloxane-free
- **一液性でハンドリングに優れる** One-component type
- **熱伝導率 3.2W/m·K** Thermal conductivity: 3.2W/m·K



塗布状態 Coating condition



サーモグラフィ画像 Therm graph
実験条件 Test condition 熱源 Heat source : 1kΩ DIP 印加電圧 Loading : 19V